



Liebe Mitglieder, liebe Interessenten,

in diesem Jahr können wir bereits jetzt auf einige interessante Aktivitäten mit Beteiligung der IMAPS zurückblicken. Nachdem es uns gelungen war, die bisher in den USA ansässige CICMT (*Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies*) im April erstmals außerhalb der USA in München zu veranstalten, können wir darüber hinaus auch von einer gelungenen Konferenz sprechen. Sowohl Teilnehmer, ob Zuhörer oder Vortragende, als auch Aussteller waren mit der Veranstaltung sehr zufrieden.

Zwischenzeitlich haben unsere Nachbarn in Skandinavien und Polen und im Oktober die IMAPS Deutschland die jährlichen Konferenzen abgehalten und auch hier für den in der aktuellen schnelllebigen Zeit notwendigen Erfahrungsaustausch gesorgt. IMAPS beteiligt sich auch an Veranstaltungen anderer Fachverbände, auf die wir auch gelegentlich an dieser Stelle verwiesen haben, wie die *Advanced Packaging* und die *Euroensors*.

Wir haben Sie in den vorherigen Ausgaben ermuntert, für die nächsten Veranstaltungen einen Termin freizuhalten oder vielleicht mit einem Beitrag dabei zu sein. Hier sei insbesondere nochmals die europäische Veranstaltung *EMPC 2009* in Rimini erwähnt, für die der Call for Papers in der Septemberausgabe abgedruckt ist.

10 Jahre LTCC Keramik in Hermsdorf

Der Hermsdorfer Keramikspezialist *VIA electronic* bietet zuverlässige und innovative Bauteile für Mess- und Steueranlagen.

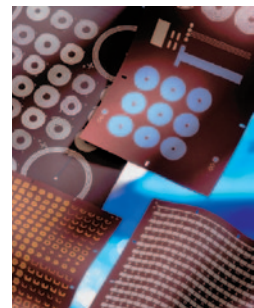
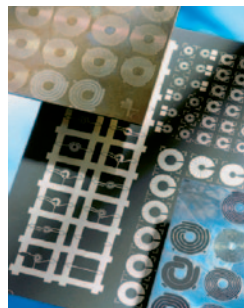
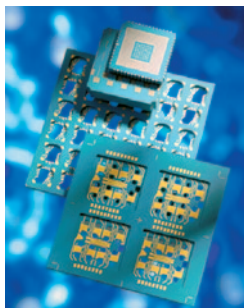
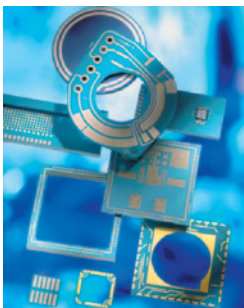
Immer größere Datenmengen müssen in immer kürzerer Zeit und auf möglichst kleinstem Raum verarbeitet wer-

den. Keramische Leiterplatten, wie sie die *VIA electronic GmbH* aus Hermsdorf anbietet, erfüllen all diese Anforderungen und sind zudem kostengünstiger als vergleichbare Halbleiterkomponenten.

Hinter der Abkürzung LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic) verbirgt sich eine Technologie, deren Basis niedrig sinternde Keramikfolien sind. Rohe Keramikfolien werden in Form gebracht, Leitungsstrukturen eingestanzt, mit Metall verfüllt und bei 900 °C zu einem kompakten Gehäuse gebrannt. Hervorragende Zuverlässigkeit und vielfältige Gehäusestrukturen zeichnen die LTCC-Technologie aus. Durch die besondere Art der Verarbeitung kann die LTCC-Keramik an die unterschiedlichsten Gehäuseanforderungen angepasst werden.

Produkte wie Multilayer-Leiterplatten oder Multichip-Module kommen beispielsweise im Automobilbau bei der Steuerung von Motoren und Drosselklappen zur Anwendung. Aber auch Unternehmen der Sensorik, der Luft- und Raumfahrt und der Medizintechnik setzen auf die Kompetenz der *VIA electronic*.

Das 1997 in Hermsdorf gegründete Unternehmen baut auf Know-how, das der Geschäftsführer *Franz Bechtold* bei seinem vormaligen Arbeitgeber, der *Siegert electronic* erworben hat. Auf *Bechtolds* Druck hin investierte *Siegert* Mitte der 90er Jahre massiv in die LTCC-Technologie und in Folge entwickelte sich daraus die Idee eines eigenen Unternehmens mit Standort Hermsdorf. Die *VIA electronic* hat sich schnell zum zuverlässigen Anbieter entwickelt und kann heute, 10 Jahre nach der Gründung, dank hoher Investitionen in eine moderne Fertigungslinien mit der entsprechenden Messtechnik und einem hochwertigen Reinraum zur Produktion der sensiblen Bauteile, renommierte Unternehmen zu seinen Kunden zählen. In deren



Auftrag fertigen die 20 Mitarbeiter jährlich Produkte mit einer Gesamtleistung von bis zu 6 Mio. Schaltungen.

Der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung innovativer LTCC-Mehrlagenkeramik bietet sowohl die Möglichkeit der Serienfertigung als auch die Produktion höchst spezialisierter Lösungen in kleinen Stückzahlen und Prototypenentwicklung. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen auch mit zahlreichen nationalen Forschungsinstituten wie der *Fraunhofer Gesellschaft IOF (Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik)* in Jena, der *Technischen Universität Ilmenau*, der *Fachhochschule Jena* und dem *Hermisdorfer Institut für Technische Keramik* im Bereich Forschung und Entwicklung zusammen.

In der Vergangenheit konnte die *VIA electronic* mit einem durchschnittlichen Wachstum von rund 20 % pro Jahr aufwarten. Auch künftig sieht Geschäftsführer *Bechtold* viel Potential für eine weitere positive Steigerung. Als frei am Markt agierendes Unternehmen, das immer für gute Partnerschaften offen ist, hat der LTCC-Hersteller in Hermsdorf beste Möglichkeiten, mit seinen hoch spezialisierten Produkten auch künftig auf dem Weltmarkt neue Kunden zu finden. Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Module, vor allem aber auch die regionale Vernetzung mit Forschungseinrichtungen machen die *VIA electronic* zu einem interessanten Partner.

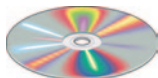
VIA electronic GmbH, Robert-Friese-Str. 3, 07629 Hermsdorf, Tel. +49/36601/81-529, Fax -530, info@via-electronic.de, www.via-electronic.de

Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Denver/Co.	20./23.4.2009	5 th CICMT	IMAPS & ACerS
Rimini	14./17.6.2009	EMPC 2009	IMAPS Europe

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings der *IMAPS-Herbsttagung 2007*, die am 8./9. Oktober 2007 in München stattgefunden hat, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

und als Papiaerausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2006*, die am 10. und 11. Oktober 2006 in München durchgeführt wurde, und der *Deutschen IMAPS-Seminare 2006 und 2007* zu den Themen *Muss jeder Sensor smart sein?* (Februar 2006 in Göppingen) und *Flip Chip – die Alternative zum Drahtbonden?* (Februar 2007 in Ilmenau) sind noch erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps, c/o Hesse & Knipps GmbH, Vättnannstraße 6, D-33100 Paderborn, Fax: 05251/1560-97, hans-ulrich.knipps@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die neu gestalteten Webseiten von *IMAPS Deutschland* im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von *IMAPS* erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

<http://www.imapseurope.org>

Impressum

IMAPS Deutschland e.V.

1. Vorsitzender:

Dr.-Ing. Jens Müller

jens.mueller@imaps.de

Schatzmeister

(bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag):

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps

hans-ulrich.knipps@imaps.de

Ausführliche Kontaktinformationen zu den Vorstandsmitgliedern findet man unter www.imaps.de (*Vorstand*)